

2005年度決算説明会

2006年 5月22日

日本電子材料株式会社
(証券コード: 6855)

将来の見通しに関する記述についての注意

本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

会社概要

- 社名: 日本電子材料株式会社
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
- 設立: 1960年4月
- 資本金: 983,100千円
- 事業内容: 半導体検査用部品(プローブカード)
(電子管部品(CRTヒータ、フィラメントなど))

半導体の製造工程

前工程

酸化

フォト
リソグラフィ

拡散
スパッタリング

ウェハテスト

後工程

ダイシング

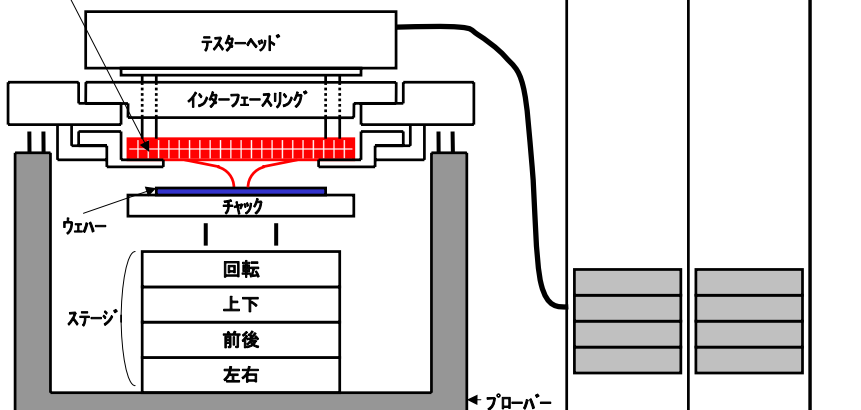
ボンディング

パッケージ

ファイナル
テスト

ウェハーテスト

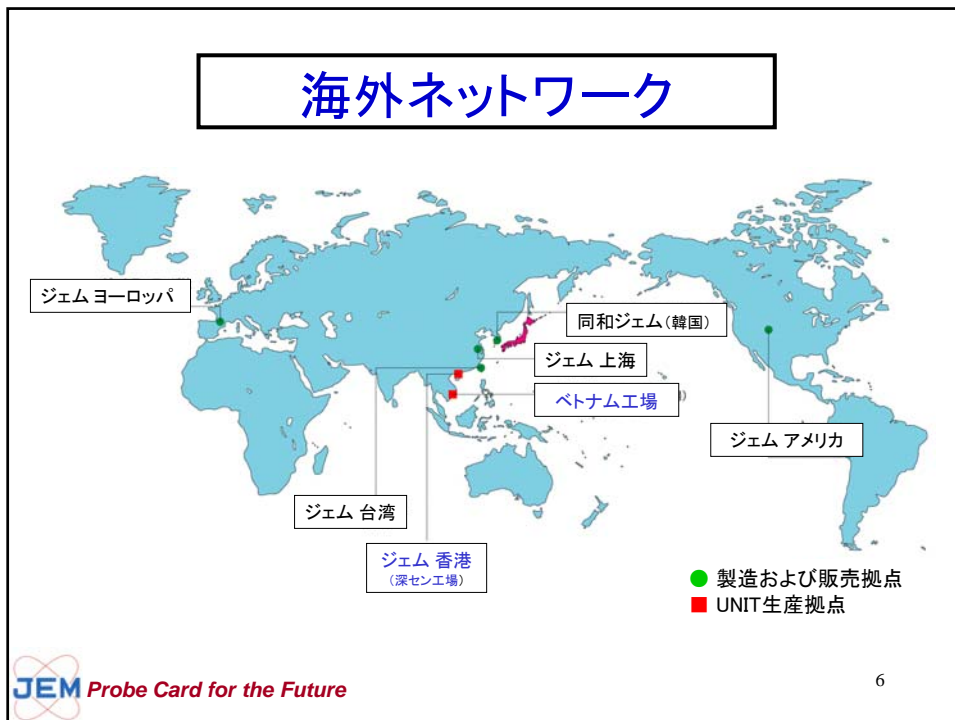
プローブカード



国内ネットワーク



海外ネットワーク



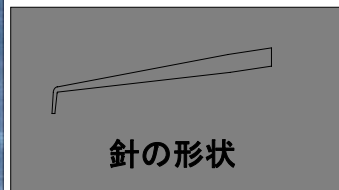
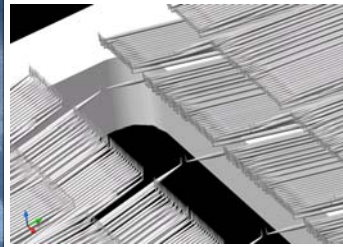
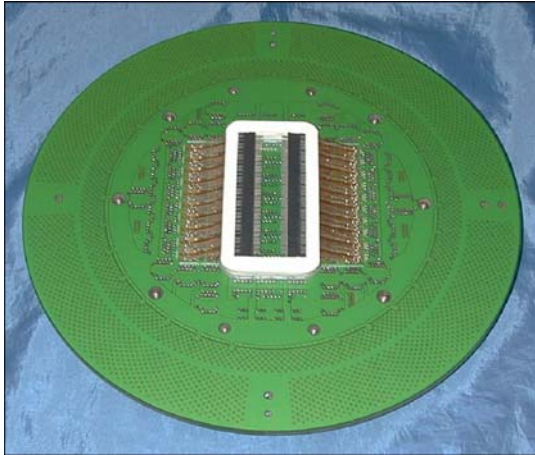
生産体制

工場	主な製品	主要支援工場	Sub 工場
熊本工場	Memory 100% Logic (システムLSI他) 40%	JEM香港 (Shenzhen)	ベトナム工場 三矢電子(熊本県)
本社工場	Logic (LCD-Dr.他) 40%	JEM香港 (Shenzhen)	ベトナム工場 比内時計工業(秋田県)
ジェム静岡	Logic(マイコン他) 20%	JEM香港 (Shenzhen)	ベトナム工場 比内時計工業(秋田県)

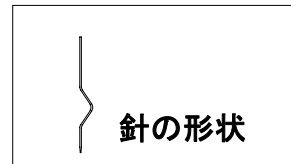
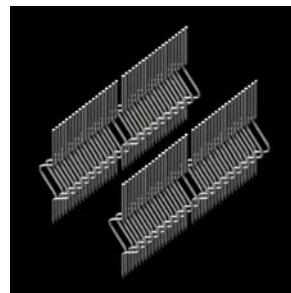
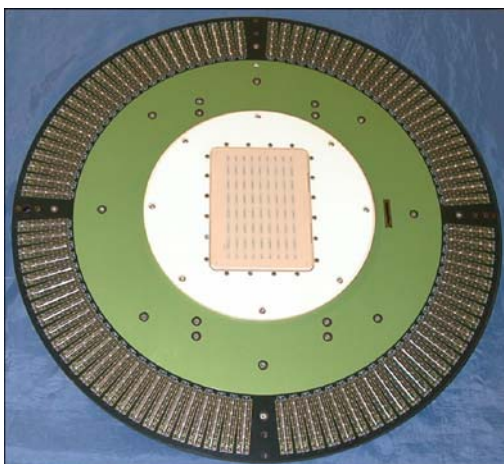
JEMのプローブカード一覧

	タイプ	シリーズ		
アドバンスドタイプ	M Type	MA (LCD)	MB (Area Array)	MC (Memory)
	V Type	VC (VCPC)	VH (HAWK)	VS (VSCC)
カンチレバータイプ	C Type	CB (Blade)		CE (Epoxy)

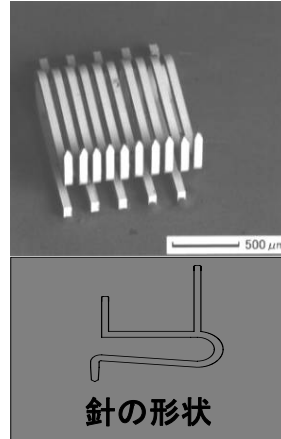
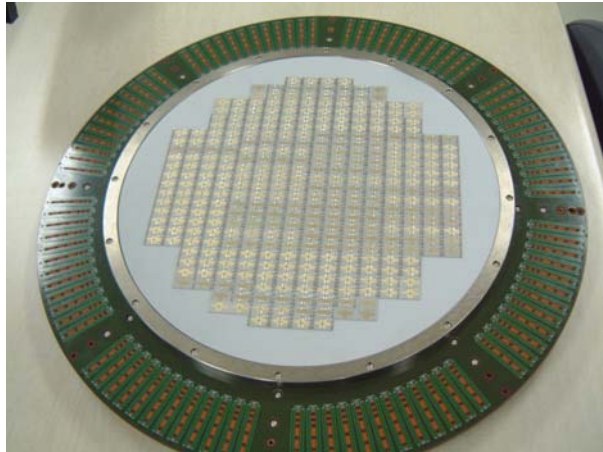
CE (カンチレバー型) の外観



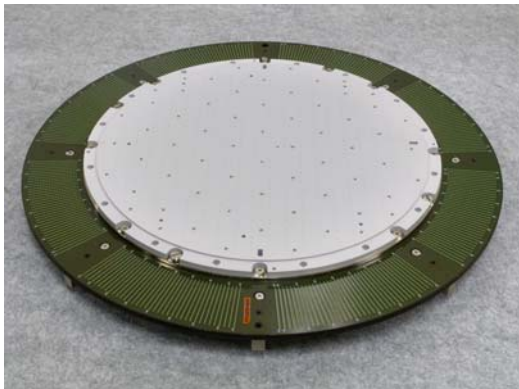
VC (垂直接触型プローブカード) の外観



VH(高密度垂直接触型プローブカード)の外観



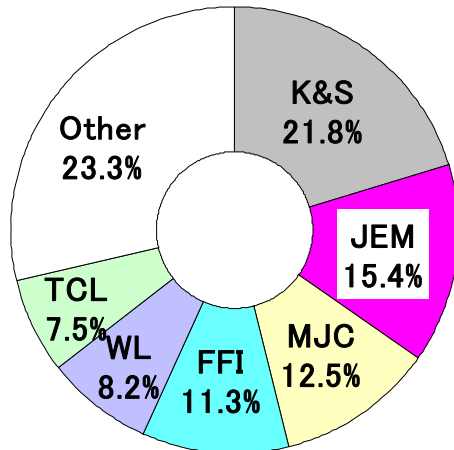
VS(垂直スプリング接触型プローブカード)の外観



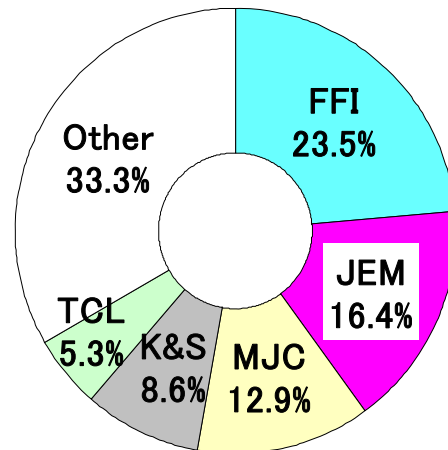
針の形状

プローブカード世界市場シェア

(2000)



(2004)



 **JEM** Probe Card for the Future

(Sources; VLSI Research Report)³

中期経営計画('04~'06年)の骨子

- 連結売上高 130億円('06年度)
- 世界シェア 20%以上
- 経常利益率 10%以上

- ロジック比率 50%
- 海外売上比率 50%
- 新事業売上 12億円('06年度)

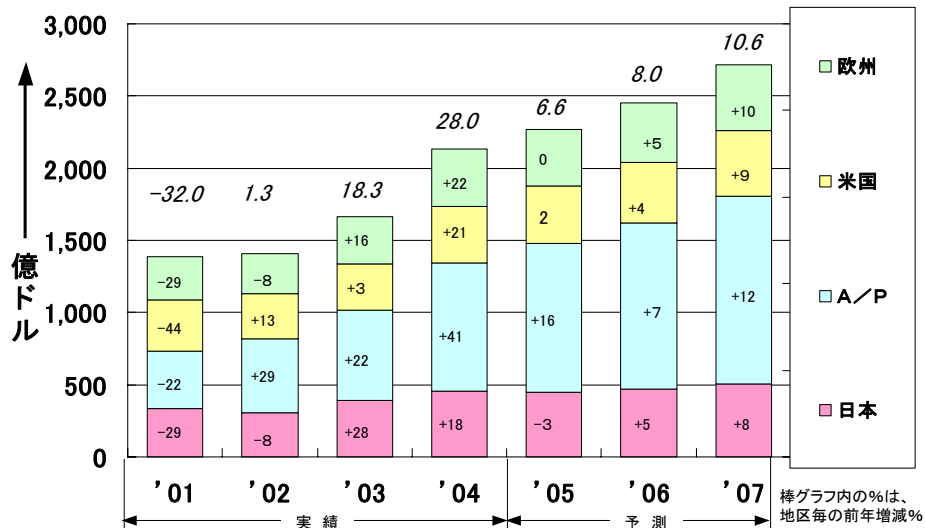
 **JEM** Probe Card for the Future

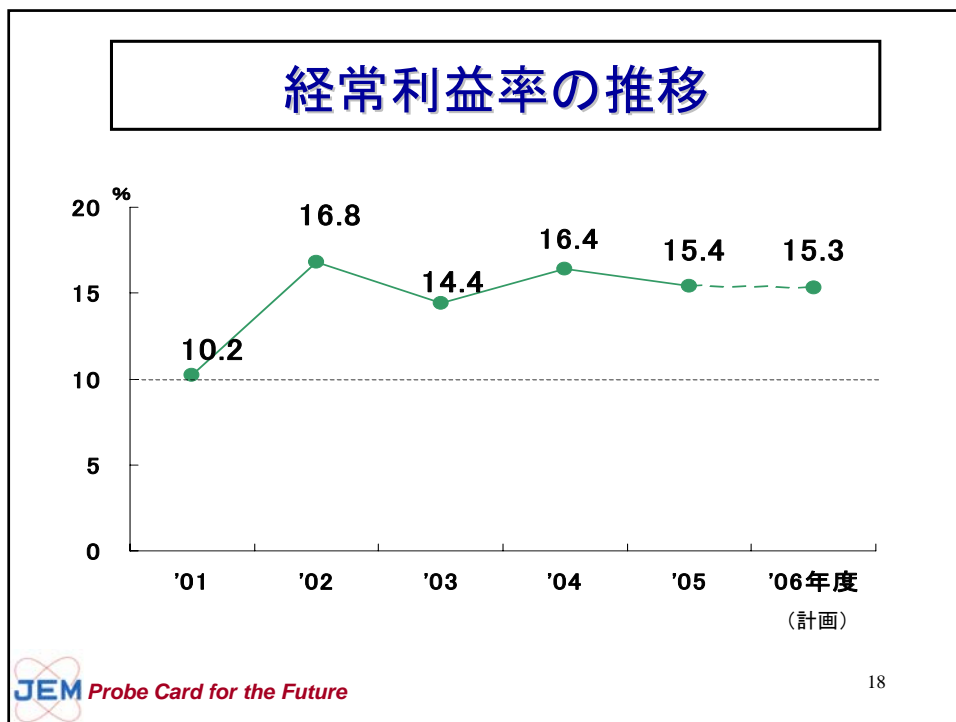
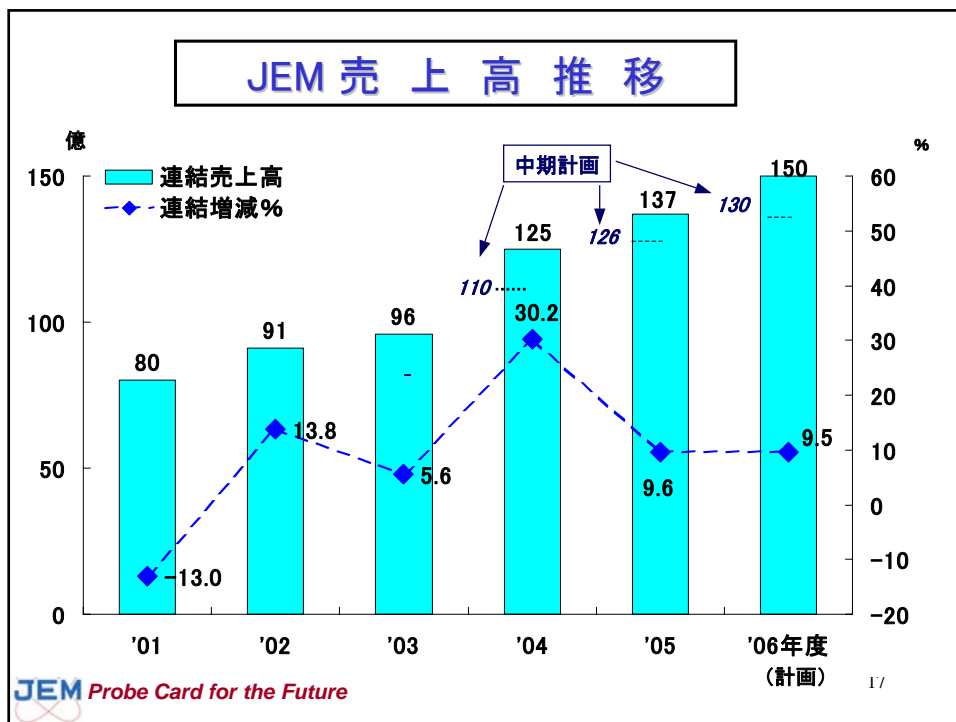
14

2005年度連結決算のポイント

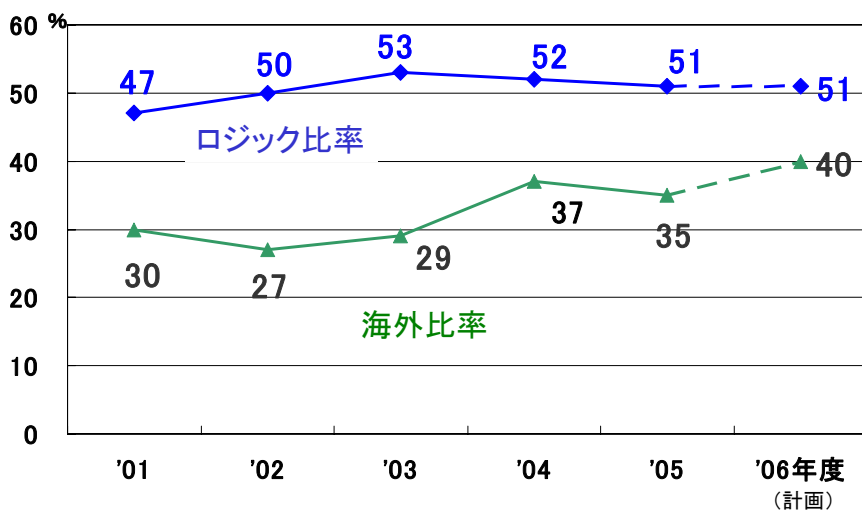
- 売上高・経常利益・当期利益
 期初、期中見通しを上回り、過去最高を更新
- VCの大增産
 前年比2倍
- システムLSI用PCの大幅受注増
 前年比1.5倍

世界の地区別 半導体市場推移





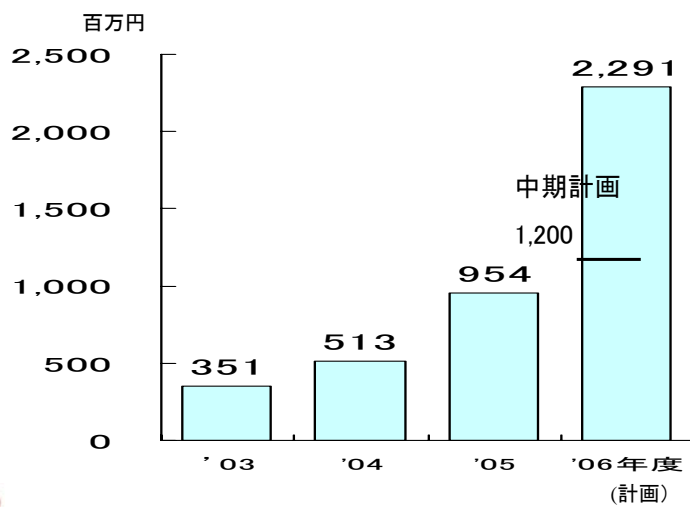
ロジック比率、海外比率



JEM Probe Card for the Future

19

新事業売上高推移



JEM Probe Card for the Future

20

‘06年事業戦略

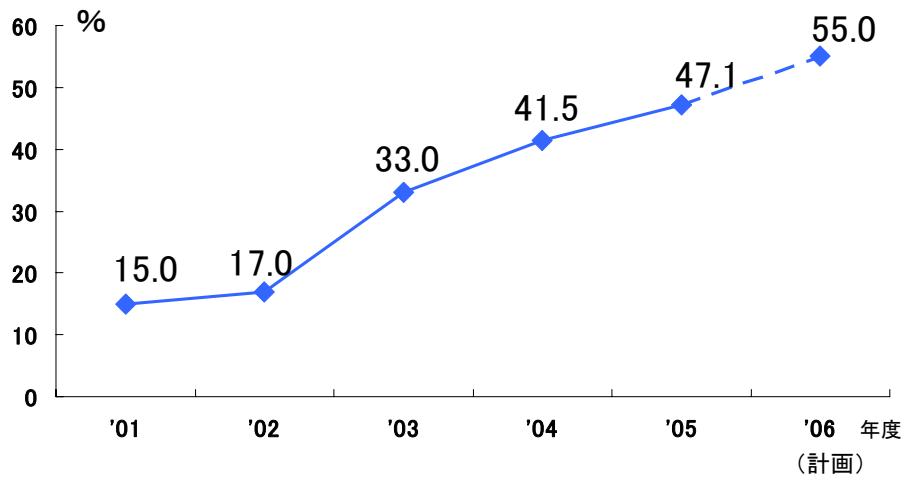
- ① アドバンスドプローブカードの
戦略的拡販
- ② 海外売上の更なる拡大
- ③ 次世代プローブカードの
開発加速と量産体制の構築

事業戦略① アドバンスドPCの戦略的拡販

アドバンスド比率 55%以上

1. VCの更なる市場拡大
使用領域の拡大、顧客開拓の推進
2. VSの更なる市場開拓と本格的量産化
メモリー向け(300mm一括PC)の本格量産
ロジック向けの更なる市場拡大
3. MA, MCの市場参入

アドバンスドプローブカード売上高比率

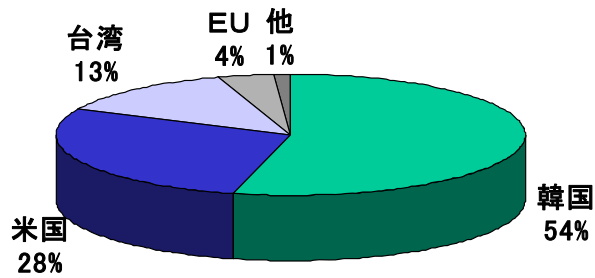


事業戦略② 海外売上 of 更なる拡大

海外売上比率 40%

1. 韓国市場の更なる拡大
三星、Hynix向けビジネスの拡大
2. 台湾ビジネスの拡大
STAr社と業務提携
3. 中国、シンガポール市場の開拓
JEMシンガポールの開設

海外売上高 構成(2005年)



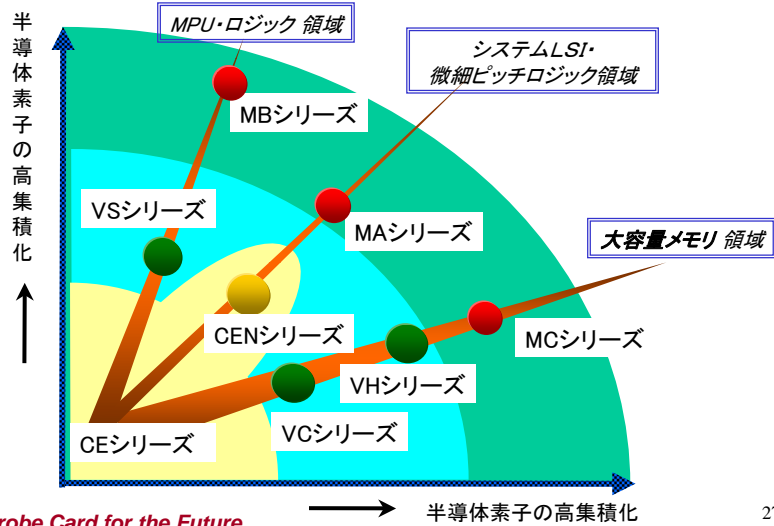
事業戦略③

次世代プローブカードの客先認証と量産体制の構築

1. MAシリーズ (LCD-Dr向け)
 - ① 製品化の加速 (客先認証)
 - ② 量産体制の構築
2. MCシリーズ (MEMORY向け)
 - ① ES品客先認定
 - ② プリプロライン構築

プローブカードロードマップ

半導体技術革新とJEM製品・技術開発の分類と方向



27

新針材プローブカードの投入

新針材 (NP3) プローブカード市場投入

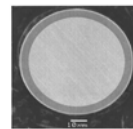
NP2の超える低針圧、狭ピッチ、安定接触を実現

1. CE (GEN) に搭載

LCD-Dr向け (安定接触)

システムLSI向け

(ダメージフリー、安定接触)



針断面

2. VC (VCN) に搭載

Flashメモリー向けの (低針圧、安定接触)

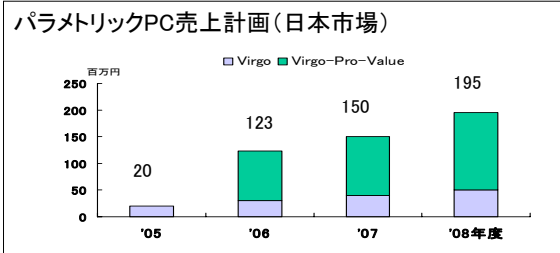
JEM Probe Card for the Future

28

新市場開拓

1. パラメトリックテスト市場の開拓

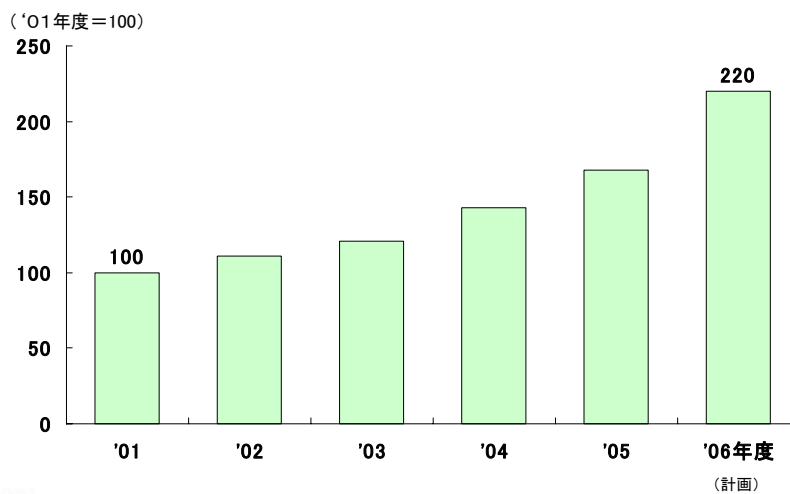
- ・STAr社と業務提携
- ・半導体製造前工程でのテスト領域を開拓



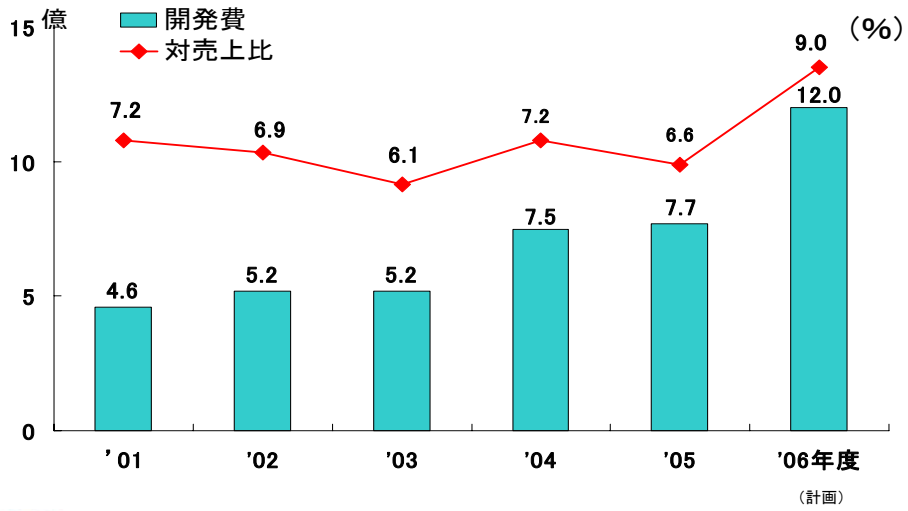
2. 特殊プローブカード市場の開拓

- イメージセンサー向けプローブカード
- 高周波対応 プローブカード

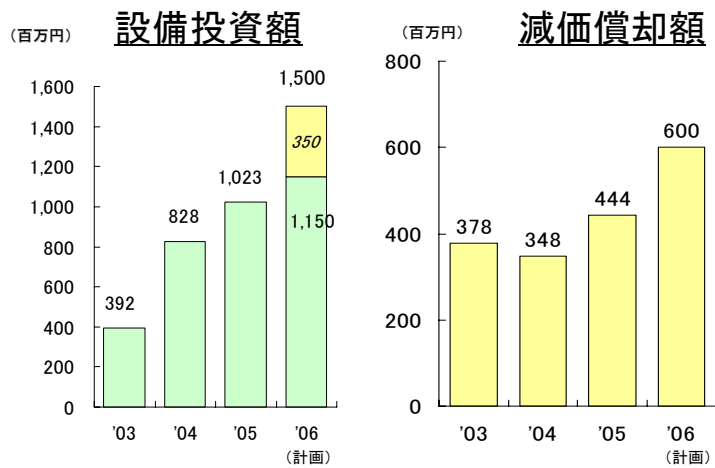
開発人員の推移



開発費の推移



設備投資額・減価償却額



'06年度業績計画

	'04年度 (実績)	'05年度 (実績)	'06年度 (計画)	対前年 増減率
売上高	12,545	13,764	15,000	9.0%
営業利益	2,052	2,049	2,260	10.3%
経常利益 (経常利益率)	2,061 (16.4%)	2,123 (15.4%)	2,300 (15.3%)	8.3%
当期純利益	1,235	1,370	1,470	7.2%

(単位:百万円)

'07年度版中期計画の骨子①

1. Mタイプの本格的市場参入と合わせて
アドバンスドPCでの技術優位性を確立する
2. アジア市場(韓国、台湾、シンガポール、中国)での
JEMの優位性を確立する
3. フィールドサポート力の強化による
CSの抜本的向上を計る

‘07年度版中期計画の骨子②

4. 育成中の新規事業売上高の連結売上比30%を目指す
5. CSRの徹底により、更なる企業イメージの向上を計る
6. ‘09年度売上高200億円以上の目標にチャレンジする